SAIE-M8B-3-F9THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Společnost Weidmüller je nyní předním světovým poskytovatelem konektorů. Stěžejním produktem v této řadě jsou kulaté konektory, které společnost Weidmüller označuje jménem SAI. Při vývoji SAI produktů se technici společnosti Weidmller vždy soustředili na dosažení racionální, cenově efektivní koncepce instalace a – spolu s hlavními uživateli – na trh dodávají velmi dobře přijímané produkty, které nastavují světové standardy ve funkčnosti a kvalitě. Nejlepším příkladem jsou nové rozvaděče M12 kódované S a T. Tyto moduly jsou charakteristické velmi vysokým proudem a napětím. Umožňuje to je použít například s třífázovými motory.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M8B-3-F9THR
Objednací číslo	2422800000
Verze	Vestavěné zástrčky, M8, M 12, Počet pólů: 3
GTIN (EAN)	4050118430103
Mnž.	25 ks

SAIE-M8B-3-F9THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	8,04 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

Kódování	M8 = ne	Montážní závit	M 10
Povrch krytu	poniklované	Počet pólů	3
Připojení stínění	Ne	Skříně	M8 konektor samice
Typ montáže	Přední montáž	Výška instalace	9 mm
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovité napětí	60 V (3 póly) / 30 V (4, 5 a 8 pólů)
Jmenovitý proud	4 A	Jmenovitý proud	4 A
Rozsah teplot	-30...80 °C	Stupeň krytí	IP67
Povrch kontaktu	Au (zlato)	Hlavní materiál krytu	CuZn, poniklované
Připojovací závit	M8	Utahovací moment	M8: 0,5 Nm
Montážní závit	M10	Rozpětí utahovacího momentu instalace	0.8 Nm
Montáž na PCB desku	Připojení pájením přetavením průchozím otvorem	Izolační síla	100 MΩ
Závažnost znečištění	3 (2 vně utěsněného prostoru)	Cykly zapojování	≥ 100
Materiál kontaktu	CuZn	Materiál těsnění	FPM
Aretační matice, materiál	Poniklovaný CuZn	Materiál krytu montovaného s přírubou	Poniklovaný CuZn
Spárovací materiál	PUR		

Systémové parametry

Montáž na PCB desku	Připojení pájením přetavením průchozím otvorem	Cykly zapojování	≥ 100
Izolační síla	100 MΩ	Množství řady kolíků	1
Počet pólů	3	Stupeň krytí	IP67

Udaje o materiálu

Materiál kontaktu	CuZn	Povrch kontaktu	Au (zlato)

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9,1	27-44-03-09	eClass 9.0	27-44-03-09

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

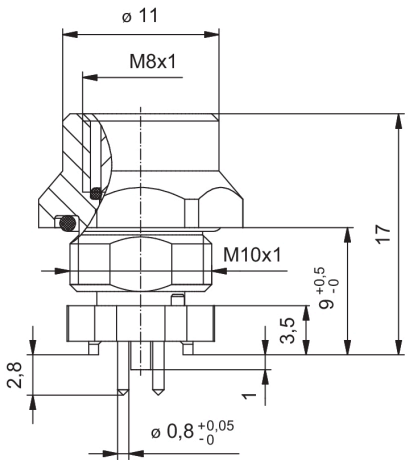
Brožura/Katalog	FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	STEP

SAIE-M8B-3-F9THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



DPS design

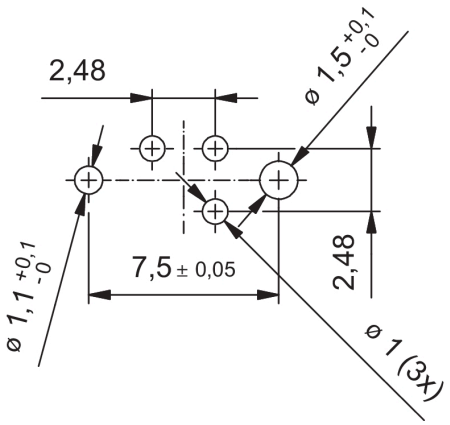
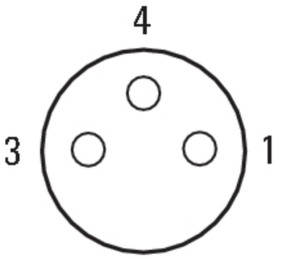


Schéma pólů

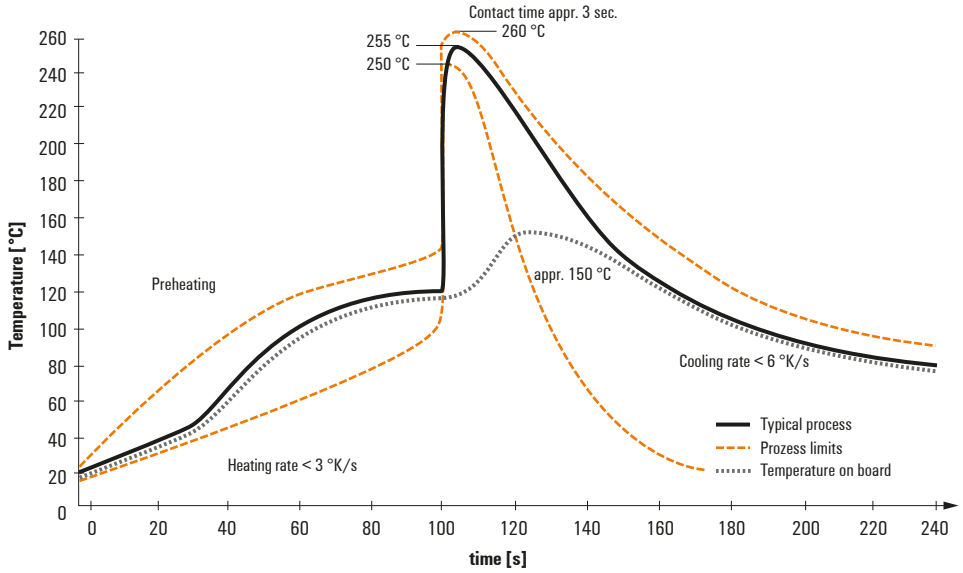


Wave Solder Profile

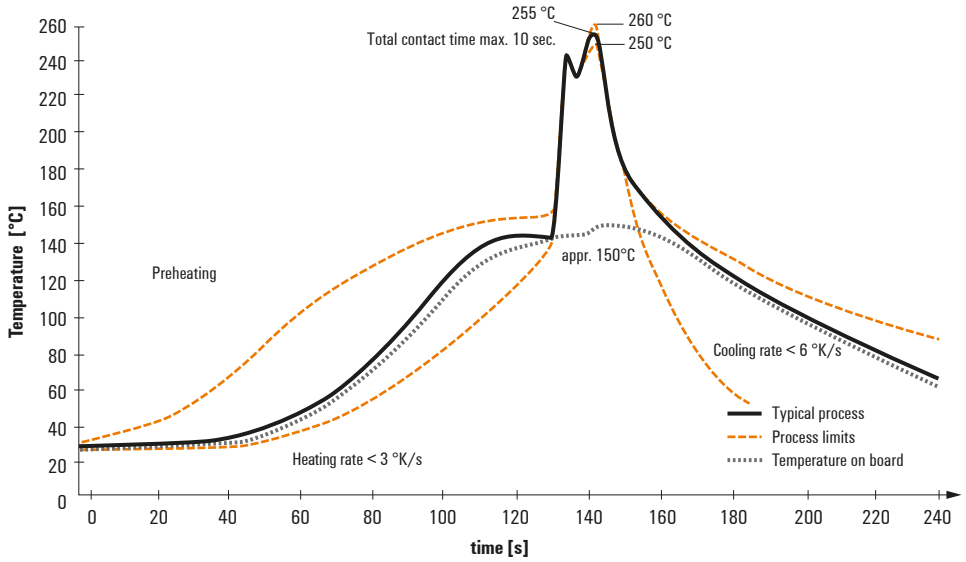
Recommended wave solderding profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

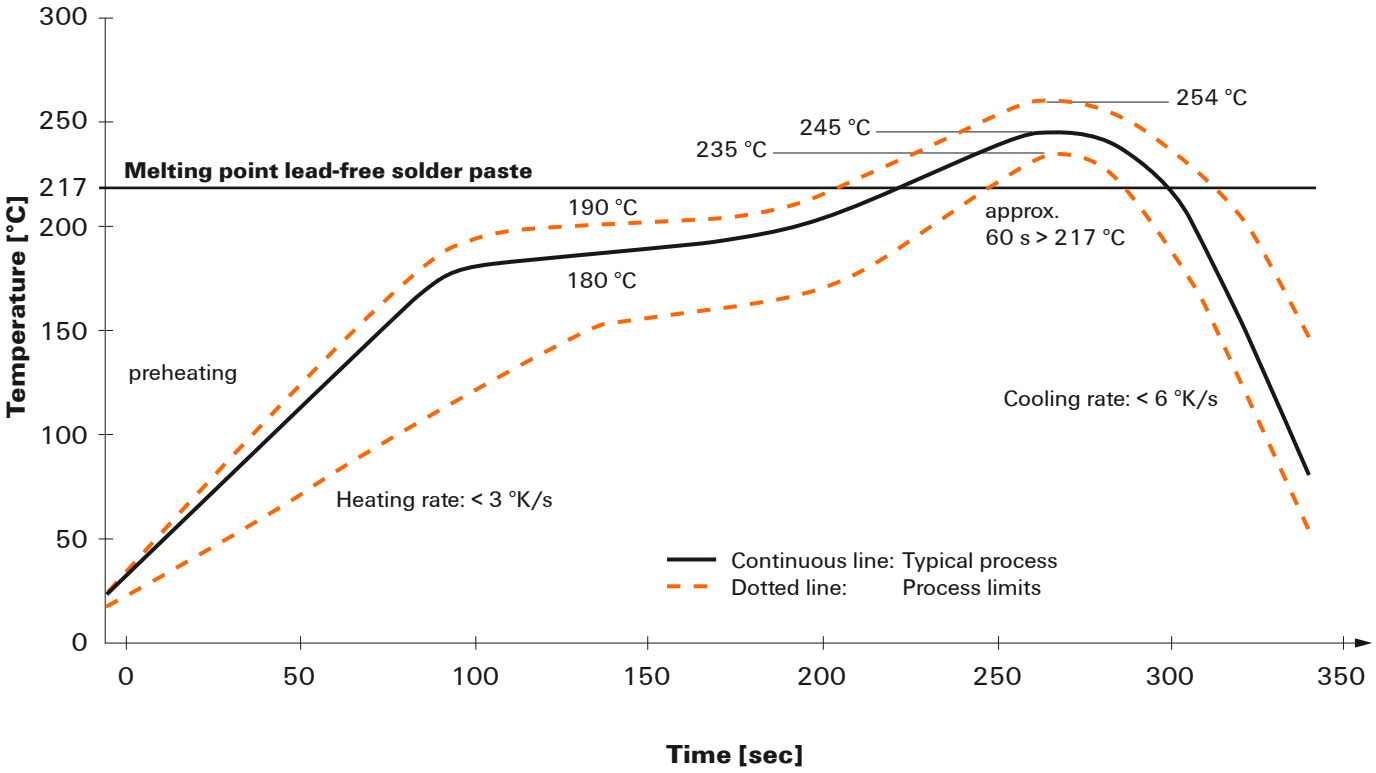
The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Reflow Solder Profile

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically ≤ +3K/s. In parallel the solder paste is ‚activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at ≥ -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.